

高介电PC 树脂的物性

项目	测试方法	条件	单位	PCR140045 (开发材料)	PCR140084 (开发材料)	PCR140085 (开发材料)
				PC基材	PC基材	PC基材
物理性能						
密度	ISO 1183			1.31	1.35	1.39
流变特性						
熔体质量流动速率	ISO 1133	300°C, 1.2kg	g/10min	11.8	9.1	6.8
熔体体积流动速率			cm ³ /10min	10.0	7.4	5.9
脱模后收缩率 (2mmt)		MD	%	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5
				TD	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5
流長比 (1mmt, 150MPa)		320°C	mm	62	50	39
机械特性						
拉伸强度	ISO 527-1 , 527-2		MPa	64	66	66
拉伸应变			%	11	4	4
抗弯强度	2ISO 178	-	MPa	110	111	110
抗弯弹性模量				3200	3700	4300
夏比冲击强度 (无缺口)	ISO 179-1 , 179-2	23°C	kJ/m ²	130	87	28
夏比冲击强度 (带缺口)		23°C		2	2	1
热特性						
热变形温度	ISO 75-1, 75-2	1.80MPa	°C	133	133	134
燃烧性	UL94			相当于V-2 (1.5mm)	相当于HB (1.5mm)	相当于HB (1.5mm)
电气性能						
相对介电常数	IEC 62562	1GHz	MD / TD	4.9/5.5	6.4/7.0	8.1/8.9
		2.45GHz	MD / TD	4.9/5.5	6.4/7.0	8.2/8.9
介质损耗		1GHz	MD / TD	0.007/0.007	0.008/0.008	0.011/0.011
		2.45GHz	MD / TD	0.006/0.006	0.007/0.007	0.011/0.012

参考：普通的PC材料的相对介电常数为2.7,介质损耗为0.007

※ 记载数据仅为代表值

Copyright Mitsubishi Engineering-Plastics Corp., All rights reserved.

